

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 4 月 19 日(19.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/049938 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) C09J 133/06 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) C09J 163/00 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/070959
- (22) 国際出願日: 2011 年 9 月 14 日(14.09.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-231124 2010 年 10 月 14 日(14.10.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 齊藤 岳史 (SAITO Takeshi) [JP/JP]; 〒3778520 群馬県渋川市中村 1 1 3 5 電気化学工業株式会社 渋川工場内 Gunma (JP). 高津 知道 (TAKATSU Tomomichi) [JP/JP]; 〒3778520 群馬県渋川市中村 1 1 3 5 電気化学工業株式会社 渋川工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 渡邊 薫, 外(WATANABE Kaoru et al.); 〒1080074 東京都港区高輪 2 丁目 2 0 番 2 9 号

サクセス泉岳寺ビル 3 階薫風国際特許事務所
Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 電子部品の製造方法

(57) Abstract: The method of the present invention is provided as a method for manufacturing an electronic component that improves the chip retention characteristics, pickup characteristics, and contamination prevention characteristics for a semiconductor chip with a good balance. The method comprises: an adhesive agent forming step that forms an adhesive semi-cured layer on the rear surface of a wafer; an attaching step for attaching an adhesive sheet to the adhesive semi-cured layer of the wafer and a ring frame and affixing the same; a dicing step that divides the wafer into semiconductor chips; an ultraviolet ray irradiation step that carries out irradiation with ultraviolet rays; and a pickup step that picks up the chips and adhesive semi-cured layer from an adhesive layer. The method uses an adhesive sheet formed by an adhesive having a prescribed composition.

(57) 要約: 半導体チップのチップ保持性、ピックアップ性、及び汚染防止性がバランスよく向上した電子部品の製造方法として、ウエハの裏面に接着剤半硬化層を形成する接着剤形成工程と、ウエハの接着剤半硬化層とリングフレームに粘着シートを貼り付けて固定する貼付工程と、ウエハを半導体チップに分割するダイシング工程と、紫外線を照射する紫外線照射工程と、チップと接着剤半硬化層を粘着層からピックアップするピックアップ工程と、を含み、粘着シートに所定の組成を有する粘着剤により粘着層を形成したものをを用いた方法を提供する。



WO 2012/049938 A1